

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2025-078

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于全资子公司专利质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开2024年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外币）的综合授信额度。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

### 一、专利质押基本情况

为盘活专利，培育高价值专利技术，公司全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与赣州银行信丰支行签订了《最高额质押合同》等相关协议，协议约定信丰迅捷兴以其自有的12项发明专利向银行提供最高限额39万元的质押担保。公司质押的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	具有挠性结构外层的刚挠结合板的光阻膜避浸润工艺	ZL201510250095.7	发明专利
2	一种PCB板的生产设备及其控制方法	ZL201710565134.1	发明专利
3	一种耐高温的液冷电路板制备方法及液冷电路板	ZL202311499494.8	发明专利
4	一种内埋器件的液冷电路板及其制备	ZL202311499486.3	发明专利

序号	专利名称	专利号	专利类型
	方法		
5	一种陶瓷混压电路板的制作方法	ZL202111016555.1	发明专利
6	一种 LED 电路板的 GERBER 设计方法及其生产工艺	ZL202111204185.4	发明专利
7	一种 PCB 板镀金手指的生产设备及其控制方法	ZL201710565528.7	发明专利
8	一种高密度 HDI 多层线路板的通孔沉铜装置及其控制方法	ZL201710565133.7	发明专利
9	一种外层挠性刚挠结合电路板线路图形的制作工艺	ZL202210271263.0	发明专利
10	一种全自动的蚀刻装置及其控制方法	ZL201710565278.7	发明专利
11	一种新型柔性线路板双面镂空线路制作方法	ZL201811172173.6	发明专利
12	一种刚挠结合电路板及其制作方法	ZL202310851633.2	发明专利

## 二、公司累计资产抵押、质押情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计抵押、质押的主要资产超过总资产的30%。公司抵押、质押的资产均用于公司及子公司自身融资担保，相关融资资金均用于日常生产经营，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

## 三、本次专利质押对公司的影响

本次专利质押旨在盘活子公司专利，培育高价值专利技术，不会影响子公司相关专利的正常使用。该项业务不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2025年12月17日